
AI, AI컴퓨팅인프라 등 최신 기술 및 산업동향 조사와 글로벌 네트워크 확보를 위한 COMPUTEX TAIPEI 2026 참관

국외출장 결과보고

- '26. 6. 1[월] ~ 6. 5[금], 대만[타이베이] -

2026. 06.

1

출장 개요

□ 추진배경

- 글로벌 IT 생태계가 AI를 중심으로 급격히 재편되면서, AI 인프라 구축 능력이 기업과 국가의 핵심 생존 전략으로 직결
- 고성능 서버 하드웨어, 고효율 쿨링 시스템 등 하드웨어 전반의 혁신이 가속화됨에 따라, Computex 2026 참관을 통해 선제적 인사이트 확보 및 비즈니스에 접목할 기회 발굴

대만 COMPUTEX 2026 행사 개요

○ 행사명 : COMPUTEX TAIPEI 2026

* 중화민국대외무역발전협회(TAITRA), 타이페이컴퓨터협회(TCA) 공동주최

○ 일시/장소 : 2026. 6. 2.(화) ~ 6. 5.(금) / 대만 Taipei Nangang Exhibition Center

○ 참가규모 : 참가기업 1,400개, 4,800개 부스, 참관객 80,000여명 등

○ 전시카테고리 : AI & Computing, Robotics & Mobility, Next-Gen Tech, Sustainable Innovation

□ 출장목적

- (산업 동향 파악) 첨단 AI반도체·서버·냉각장치 등 최신 AI인프라 관련 기술 및 산업동향을 파악하고 향후 사업 추진에 활용
- (글로벌 네트워크 확보) 주요 글로벌 기업과의 교류를 통해 국내 AI인프라 구축과 연계 가능한 협력 분야 발굴 및 글로벌 협력기반을 마련

□ 출장일정(출장지) : 2026. 6. 1.(월) ~ 6. 5.(금), [대만 타이베이]

□ 출장자 및 주요업무

소 속	성 명	출장기간	주요업무
AI인프라확충팀	정도균 수석	6.1.(월) ~ 6.5.(금) (4박 5일)	- 고성능 AI서버, 서버냉각 기업 등 부스 방문, 최신 산업 동향 조사 - 유관 산업 관련 국내·글로벌 기업 미팅을 통한 비즈니스 등 발굴
	한상범 책임		
	박예찬 책임		
클라우드팀	정은주 수석		- 데이터센터 기업 등 부스 방문, 최신 산업 동향 조사
	손예지 책임		
AI반도체확산팀	안연수 선임		- AI반도체 관련 기업 등 부스 방문, 최신 산업 동향 조사

□ 주요 활동 계획

- 주요 컨퍼런스 및 부대행사에 참여하여 AI인프라 관련 주요 기술 트렌드, 시장 전망, 기업별 기술 전략 정보 수집
- 전시관 참관 및 글로벌 기업 교류를 통해 AI인프라 산업 현황을 파악하고, 우리 원 사업과 협업 및 개선 방안 발굴 등 네트워크 강화

□ 세부 일정

일 정		방문지역	내용
1일차	6.1(월)	인천(ICN)- 타이완(TPE)	• 인천출발 13:55 → 타이완 도착 15:30 • 전시 사전 등록 및 출입카드 수령 • COMPUTEX 2026 동선 참가기업 리스트 등 사전점검
2일차	6.2(화)	타이완(TPE)	• COMPUTEX 2026 행사 참관 - 기조연설(Intel, Marvel 등) 및 전시관 참석 • 참가기업 협력 회의
3일차	6.3(수)		• COMPUTEX 2026 행사 참관 - AI반도체기업(기가바이트, 인텔 등) 전시관 방문 • 주요 유관기관 네트워킹 회의
4일차	6.4(목)		• COMPUTEX 2026 행사 참관 - AI스타트업 전시관 방문 • 주요 유통망 관련 기업 및 기관 네트워킹 회의
5일차	6.5(금)	타이완(TPE)- 인천(ICN)	• 타이완 출발 12:25 → 인천 도착 15:55

< AI인프라 주요 기업 글로벌 네트워킹 회의 사전 미팅 >

- 일시/장소 : '26.6.2.(화), 10:00~14:00, 전시회장 인근
- 참석대상 : 코아시아, 대만한인회, NIPA 등 8명
 - * 정도균 수석, 박예찬 책임, 한상범 책임, 안연수 선임, 신동수 CEO, 이덕영 전무, 이재승 매니저, 이수정 회장
- 주요내용 : 현지 대만 AI인프라 기업 회의를 위한 사전 준비사항 논의 등

< AI인프라 주요 기업(Accton, Edge-core) 네트워킹 회의 >

- 일시/장소 : '26.6.3.(수), 10:00~14:00, 시먼 일대 및 전시회장 인근
- 참석대상 : Accton, Edge-core, 코아시아, NIPA 등 10명
 - * 정도균 수석, 한상범 책임, 안연수 선임, 신동수 CEO, 이덕영 전무, 이재승 매니저, Rick Wu 과장, Pual Kim CIO, 김민철 이사장, Lin Yi Neng 박사,
- 주요내용 : Accton, Edge-core 주요제품 소개 및 글로벌 협력 방안 논의 등

< AI인프라 주요 기업(Inventec & Pegatron & 한중경제협회) 네트워킹 회의 >

- 일시/장소 : '26.6.4.(목), 10:00~18:00, 시먼 일대 및 전시회장 인근
- 참석대상 : Inventec, Pegatron, 한중경제협회, 코아시아, NIPA 등 13명
 - * 정도균 수석, 한상범 책임, 안연수 선임, 신동수 CEO, 이덕영 전무, 이재승 매니저, 서정원 부회장, Justen Chen, Roger Cheng, Sunday Liu, Henry Tsai, Wenchen Chen, Kevin Chein
- 주요내용 : Inventec, Pegatron 주요제품 소개 및 글로벌 협력 방안 논의 등

2

출장 결과

□ 개요

- Computex 2026은 AI에이전트와 피지컬AI 확산으로, 데이터센터가 지능을 생산·운영하는 'AI 팩토리(AI Factory)'로 진화하고 있음을 보여줌
 - 이에, 주요 글로벌 반도체·시스템 기업들은 랙스케일 통합 플랫폼, 고속 인터커넥트, 전력·냉각 솔루션 등 AI 워크로드 최적화를 위한 핵심 기술을 제시

□ 주요 내용

- (AI컴퓨팅 인프라) AI 수요 급증에 대응하기 위한 시스템(Rack) 단위의 컴퓨팅 인프라와 고성능 엣지 컴퓨팅 제품 전시

① AI Server ODM / Rack Integration

기업명	주요내용
ACER (대만)	▪ 글로벌 ICT 기업으로서 Acer 본사는 AI PC 비중이 크며, 그룹사 Altos Computing이 AI 서버·HPC·인프라 영역을 담당 ▪ 자회사 Altos를 통해 고밀도 폼팩터 기반의 AI 서버 및 HPC 인프라 솔루션을 전개. 한정된 공간 내에 다중 컴퓨트 노드와 고성능 GPU 및 대용량 ECC 메모리를 집적하는 서버 아키텍처를 제시  
GIGABYTE (대만)	▪ GIGABYTE 본사는 차세대 AI PC 및 프리미엄 컴포넌트를 선보였으며, 자회사 Giga Computing이 AI 서버·HPC·데이터센터 인프라 영역을 전담 ▪ 기존 방식을 넘어 배치를 가속화하는 '모듈형 AI 인프라 플랫폼 (GADU)'을 제시. 고밀도 컴퓨팅, 전력 분배, 액체·침지 냉각을 통합해 다양한 환경에서 AI 용량을 신속하게 확장하는 아키텍처를 전개  

기업명	주요내용
Bellwether (대만)	▪ 커넥터, 케이블, Pogo, FPCA, 금속사출 부품 등을 설계·생산하는 대만 전자부품 기업으로, AI 서버용 커넥터/배선류 공급 ▪ AI 서버 및 데이터센터 인프라용 초고속 커넥터, 고전류 배선류 (케이블링 시스템) 등 고신뢰성 인터커넥트 부품 공급망 전시  
Inventec (英業達集團) (대만)	▪ 서버, 노트북, 엔터프라이즈 장비를 생산하는 대만 ODM/전자제조 그룹으로 AI 인프라와 Physical AI 사업 확장중 ▪ 차세대 GPU 아키텍처 기반의 엣지 AI 서버와 Physical AI 인프라 솔루션 공개, 대규모 생성형 AI 모델을 엣지에서 직접 구동할 수 있는 고성능 컴퓨팅 구조 제시  
ASRock Rack (대만)	▪ 클라우드·서버·AI 인프라용 서버 하드웨어를 개발하는 대만 서버 전문 기업 ▪ NVIDIA 차세대 플랫폼 기반의 액체냉각 랙 솔루션 및 다양한 폼 팩터의 DLC(Direct Liquid Cooling) 서버 라인업 공개. 복잡한 에이전틱 및 강화학습 워크로드를 가속화하는 최적화 구조 제시  

기업명	주요내용
MiTAC (대만)	■ AI/HPC/클라우드용 서버·랙·클러스터 솔루션을 제공하는 대만계 컴퓨팅 인프라 업체 ■ 고밀도 액체냉각 랙 시스템, 다중 GPU 가속 서버 및 모듈형 데이터센터 솔루션 제공. 공랭 한계를 극복한 고효율 냉각 구조를 통해 고온의 흡기 조건에서도 안정적인 토큰 생성 성능 제시 * 표준 대비 랙당 GPU 밀도 50% 향상, 기존 대비 최대 50% 많은 토큰 생성 가능
ASUS (대만)	■ PC, 노트북 등 하드웨어 제조 기업으로서 차세대 AI PC 및 프리미엄 컴포넌트 라인업을 선보였으며, AI 서버 및 데이터센터 인프라 영역의 포트폴리오를 대폭 강화 ■ AI 서버 및 데이터센터 인프라용 엔비디아 블랙웰 기반 고밀도 GPU 서버, 하이브리드 액체냉각 솔루션 등 고성능·고효율의 엔드 투엔드(End-to-End) AI 하드웨어 플랫폼 공급망 전시
COMPAL (대만)	■ 글로벌 ICT 제조 ODM기업으로서 엔비디아 GPU 기반의 차세대 AI 서버 라인업을 전시하며 데이터센터 영역으로 포트폴리오를 다변화 ■ AI 서버 및 데이터센터 인프라용 엔비디아 고성능 가속 서버 플랫폼, 발열 및 전력 효율을 극대화한 친환경 액침냉각시스템 전시

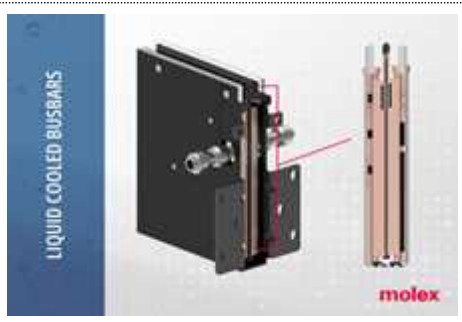
기업명	주요내용
MSI (대만)	- PC 및 서버 하드웨어 제조 기업으로서 차세대 AI PC 및 게이밍 라인업을 선보였으며, 자체 서버 사업부를 통해 AI 데이터센터 및 HPC 인프라 영역 전개 - AI 서버 및 데이터센터 인프라용 엔비디아 블랙웰 기반 고성능 GPU 서버 플랫폼, 고밀도 컴퓨팅 환경에 최적화된 맞춤형 액체 냉각 솔루션 전시  
PEGATRON (대만)	- 대만의 세계적인 전자제품 위탁생산 강자로서, 차세대 AI 데이터센터 및 고성능 서버 인프라 시장으로 사업 포트폴리오를 빠르게 확장 - AI 서버 및 데이터센터 인프라용 엔비디아 블랙웰 기반 고성능 GPU 서버 플랫폼, 고밀도 컴퓨팅 환경에 최적화된 맞춤형 액체 냉각 솔루션 전시  
SUPERMICRO (미국)	- 미국의 글로벌 가속 컴퓨팅 선도 기업으로서, 빅테크 파트너십 기반의 고성능 AI 서버 및 데이터센터 시장 주도권 강화 - 엔비디아 블랙웰 아키텍처 기반의 차세대 AI 시스템 및 데이터센터 효율을 극대화하는 맞춤형 액체냉각(DLC) 솔루션 전시  

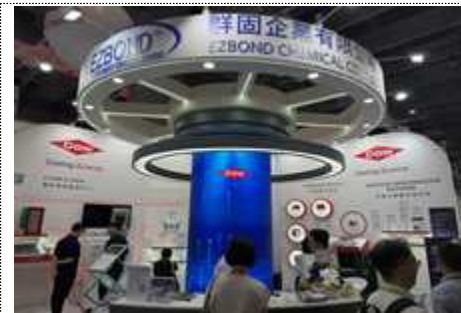
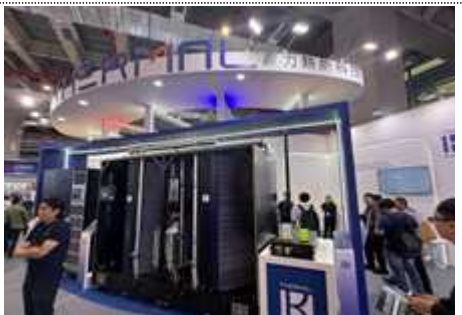
② GPU / AI Compute Core

기업명	주요내용
Media Tek (대만)	- 스마트폰·네트워킹·자동차·커스텀 데이터센터 ASIC까지 아우르는 대만 팹리스 반도체 기업 - 데이터센터 솔루션을 중심으로 커스텀 반도체 설계 기술 및 랙 수준의 시스템 통합과 함께, 반도체-광신호 연결 기술인 CPO 및 MicroLED 기반 인터커넥트 기술을 통한 전력 절감 솔루션 제공  

③ Power / Cooling Infrastructure

기업명	주요내용
Vertiv (미국)	- 데이터센터·통신망용 전력, 열관리, 랙, 모듈형 인프라를 제공하는 글로벌 디지털 인프라 기업 - AI 팩토리 아키텍처에 대응하기 위한 고밀도 액체냉각 및 직류(DC) 전력 토털 솔루션 공개, 인프라 구축 기간을 단축하는 반복 설계 기반의 모듈형 전력 배치 기술 제공  
LITEON (대만)	- 광전자·전원·클라우드 인프라·스마트시티 솔루션을 전개하는 대만 전자기업 - 차세대 초고밀도 AI 서버 인프라에 대응하는 고전압 직류 전력 아키텍처 기반의 파워 랙(Power Rack) 및 인랙(In-Rack) 액체냉각 솔루션 공개, 고용량 파워 셀과 CDU의 통합을 통한 효율적인 전력·열관리 솔루션 제공  

기업명	주요내용
Delta Electronics (대만)	■ 전원전자, 산업자동화, 인프라, 열관리 분야의 대만 대표 기업 ■ AI 모듈러 데이터센터, 데이터센터 마이크로그리드, 800VDC 고전압 전원장치 및 직접 액체냉각 기술 보유, 전력 변환 효율을 극대화한 파워 셀과 대용량 CDU 제품군을 통해 고밀도 랙 인프라 지원 * 공사 기간을 최대 60% 단축 가능한 AI Modular Data Center 인프라 지원  
VTC (Vitalcore Technology) (대만)	■ AI PC 및 데이터센터용 열관리·액체냉각 터키 솔루션을 제공하는 대만 열관리 업체 ■ 고성능 AI 데이터센터의 고발열 문제를 해결하기 위한 CDU, 고밀도 랙, 매니폴드, 콜드플레이트 등 수냉/액체냉각 전반의 하드웨어 터키 인프라 솔루션 제공  
Molex (미국)	■ 커넥터·인터커넥트·전력·광통신 솔루션을 공급하는 글로벌 연결 솔루션 기업 ■ 차세대 AI 데이터센터 규격에 대응하는 수냉 부스바(Liquid Cooled Busbar) 기술과 초고속 고밀도 인터커넥트 솔루션 제공 * 다채널 냉각 경로 설계를 통해 전력 배전 효율 향상과 전력 밀도 증가에 따른 발열을 억제. 단일 채널 대비 최대 20% 냉각 효율 향상 가능  

기업명	주요내용
EA-HWA (대만)	- 서버랙, 19인치 네트워크 캐비닛, OCP 오픈랙 등을 제조하는 대만 랙 인프라 업체 - 오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP) 표준 규격 기반의 초고밀도 AI/HPC 전용 오픈랙(ORv3) 인프라 제공. 고전압 버스바 장착 및 공랭, 액체냉각(Liquid-to-Air, D2C) 시스템 지원으로 내진 안정성 강화  
DOW (미국)	- 첨단 소재·화학 솔루션을 공급하는 글로벌 소재기업으로 AI 시대 열관리 소재를 적극 확장 중 - 데이터센터 액체냉각 및 침지냉각(Immersion Cooling) 시스템을 위한 전용 플루이드 기술과, 차세대 초고속 광트랜시버 및 패키징 공정에 필수적인 고성능 열계면소재(TIM) 제품군 제공  
KAORI THERMAL (대만)	- 데이터센터용 액체냉각 솔루션과 OEM/DFM 서비스를 제공하는 대만 열관리 기업 - CAI 서버 랙 인프라의 핵심인 CDU(냉각분배장치), 침지냉각 탱크(Immersion Tank), 파이프라인 네트워크 및 중앙 집중식 온도 제어 시스템 등 종합 액체냉각 시스템 설계 및 OEM/DFM 엔지니어링 제공  

④ Storage / Memory / Data Layer

기업명	주요내용
PASCARI (대만)	- Phison Electronics(대만)가 전개하는 엔터프라이즈 SSD 브랜드로, AI·클라우드·하이퍼스케일 스토리지 제공 - 대규모 AI 데이터 세트 및 하이퍼스케일 환경 처리를 위한 고성능 엔터프라이즈 PCIe Gen5 NVMe SSD 라인업 공개. 고용량 스토리지 및 액체냉각 대응 설계 기술 제시  
PROMISE Technology (대만)	기업용 스토리지와 AI·감시·미디어용 고성능 저장장치를 개발하는 대만 스토리지 전문기업 - AI 연산 데이터 가속을 위한 스토리지 플랫폼과 All-Flash 어레이 솔루션 공개. 고대역폭 네트워크 환경을 위한 RDMA/RoCE 및 차세대 인텔 아키텍처 기반의 대용량 고속 데이터 레이어 인프라 제공  
SSSTC (Solid State Storage Technology Corporation) (대만)	- 키옥시아(Kioxia) 그룹의 기업용 SSD 전문 제조 대만 자회사로서, AI 서버 및 클라우드 데이터센터의 초고속 데이터 처리에 특화된 고성능 엔터프라이즈 스토리지 제품군을 제조 - 대규모 AI 데이터 세트 및 하이퍼스케일 환경 처리를 위한 고성능 엔터프라이즈 PCIe Gen5 NVMe SSD 라인업 공개. 고용량 스토리지 및 액체냉각 대응 설계 기술 제시  

⑤ AI semiconductors

기업명	주요내용
SK하이닉스 (한국)	- 고대역폭 메모리(HBM) 시장을 선도하는 반도체 기업 - 차세대 고대역폭메모리 'HBM4E' 상세 스펙 공개 및 신개념 낸드 솔루션 'HBF(High Bandwidth Flash)' 세계 최초 공개  
삼성 (한국)	- 고대역폭 메모리(HBM) 시장을 선도하는 반도체 기업 - 차세대 고대역폭메모리 'HBM5' 세계 최초 공개  
한미반도체 (한국)	HBM4 생산용 TC 본더 4 장비와 차세대 와이드 TC 본더(WIDE TC BONDER) 전격 공개  
딥엑스 (한국)	- AI 반도체(NPU) 원천기술을 기반으로 한 엣지 AI반도체 전문 기업 1세대 NPU DX-M1의 다양한 제품군을 전시하며 어드밴텍과 저전력, 저발열 로봇 제어와 인식 플랫폼을 소개  

- (기타) COMPUTEX 2026 기조연설에서 퀄컴과 마벨, 인텔, NXP는 AI 패러다임 전환에 따른 하드웨어, 데이터 연결성, 컴퓨팅 인프라 혁신 전략을 발표하였고, 엔베디아는 NVIDIA GTC Taipei에서 컴퓨팅의 근간이 데이터센터에서 에이전트형 AI환경으로 전환되고 있음을 보여줌

< COMPUTEX 2026 기조연설 주요내용 >

기업(발표자)	주요 내용
Qualcomm (CEO 크리스티아누 아르만도)	▶ AI가 자율적으로 의도를 파악하고 복잡한 작업을 수행하는 '에이전트' 중심으로 컴퓨팅 패러다임이 변화함 ▶ 에이전트 구동을 위해 전력 효율이 극대화된 통합 하드웨어 (CPU, NPU, GPU)가 필수적임 ▶ 개인 기기(폰, PC)를 넘어 자동차, 로봇틱스, 6G 네트워크 등 물리적 영역으로 AI가 통합됨 ▶ 급증하는 AI '토큰' 수요에 대응하기 위해 기기(엣지)와 클라우드 간 최적화된 연산 배분이 핵심임 ▶ 데이터 센터 시장 공략을 위한 새로운 제품군 브랜드 'Dragonfly' 공개
Marvell (CEO 맷 머피)	▶ 컴퓨트와 메모리를 넘어 방대한 데이터 이동을 지원하는 연결성이 AI 인프라의 새로운 병목 현상으로 부각됨 ▶ Marvell은 가전 중심에서 데이터 인프라 기업으로 체질을 개선하여 데이터 센터 매출 비중을 75% 이상으로 확대함 ▶ 엔비디아와의 협력을 통해 AI 에이전트 시대 분산 데이터 센터 환경에서 Marvell 인터커넥트 기술의 필수성을 강조함 ▶ 데이터 센터 내부 연결이 구리에서 광학으로 전환됨에 따라 1.6T 광 모듈 및 공동 패키징 광학(CPO) 기술을 추진함 ▶ ASE와의 협력 및 대만 반도체 생태계를 통해 거리 제약 없이 하나의 기계처럼 작동하는 AI 인프라 미래를 제시함
Intel (CEO 립부 탄)	▶ PC, 엣지(Edge), 데이터 센터, 물리적 AI라는 4가지 핵심 영역에서 실리콘, 시스템, 소프트웨어의 통합 혁신을 강조 ▶ 인텔 코어 울트라 시리즈 3로 PC를 에이전트형 AI 플랫폼으로 바꾸고 휴대용 게이밍용 ARC G3 GPU를 발표 ▶ 최대 288개 E-코어를 탑재한 인텔 제온 6 플러스 프로세서로 에이전트 AI 처리 효율을 높임 ▶ 폭스콘, 삼바노바와 랙 스케일 솔루션을 구축하고 구글, 에릭슨과 협력해 맞춤형 실리콘 시장에 진출함 ▶ 지난 1년간 엔지니어링 중심으로 체질을 바꿔 AI 시대의 고효율 컴퓨팅을 빠르게 실행하겠다는 의지를 밝힘

< NVIDIA GTC Taipei 2026 기조연설 주요내용 >

기업(발표자)	주요 내용
NVIDIA (CEO 젠슨 황)	▶ AI가 도구를 사용하고 문제를 해결하는 '에이전트' 형태로 진화하며 코딩 및 자동화 작업에서 역할이 강조됨 ▶ 에이전트형 AI 처리에 최적화된 차세대 멀티 랙 포드 규모 슈퍼컴퓨터인 'Vera Rubin'이 전면 양산 중임 ▶ AI 에이전트를 위해 최초로 설계된 'Vera CPU'를 통해 복잡한 연산과 데이터 액세스 요구를 충족함 ▶ 마이크로소프트와 협력하여 에이전트형 AI를 로컬에서 실행하는 차세대 PC 플랫폼 'RTX Spark'를 발표함 ▶ 물리 AI 모델 'Cosmos 3'와 휴머노이드 로봇 플랫폼 'Isaac Groot'를 통해 로봇틱스 개발 가속화를 지원함

□ 시사점

- AI컴퓨팅 인프라는 개별 칩 성능 경쟁에서 냉각·전력 장치를 통합한 랙 스케일 및 모듈형 인프라로 패러다임 전환
 - 고밀도 발열 제어를 위한 수냉·액침 냉각 기술과 전력 분배가 하나의 플랫폼으로 묶여 공급됨
 - 또한, 전력 과부하와 데이터 병목 해결을 위한 ‘하이브리드 AI(분산 연산)’, ‘CPO*/초고속 스위치’, ‘800V DC 고전압 및 직접 액체냉각 (DLC)’ 기술이 AIDC 성능을 결정하는 핵심 표준으로 부상
 - * CPO(Co-Packaged Optics, 공동 패키지 광학) : 데이터센터의 전기 신호를 빛으로 전환하여 초고속으로 데이터를 전송하는 기술, 데이터 병목과 전력 소모 문제 해결 핵심 인프라
 - 이에 따라 하드웨어와 냉각 솔루션을 턴키로 제공하는 AI 팩토리 형태의 인프라 구축이 가속화됨
- AI반도체는 거대 모델의 초고비용 학습 단계에서 실환경 서비스 적용을 위한 고효율 추론 및 에지로 중심축 이동
 - 서비스 상용화에 맞춰 전력대비 비용 효율을 극대화한 맞춤형 가속기(ASIC) 수요가 급증함
 - 데이터센터 의존도를 낮추고 로컬에서 온디바이스 에이전트를 구동하기 위한 고성능 NPU 경쟁이 심화됨

3

참가기업 회의

AI인프라확충팀&AI반도체확산팀

□ COASIA & 대만한인회

- (일시) 2026. 6. 2.(화) 10:00~14:00
- (장소) Nankang Software Park Post Office 13층 회의실
- (참석자) NIPA 정도균 수석, 박예찬 책임, 한상범 책임, 안연수 선임, 코아시아 신동승 CEO, 이덕형 전무, 이재승 매니저, 대만한인회 이수정 회장 등 8명
- (주요내용) 현지 대만 AI인프라 기업 회의를 위한 사전 준비사항 논의

< 회의 주요내용 >

■ 기관별 사전 준비 및 본 회의 대응 역할 논의

- (대만한인회) 한국 정부의 GPUaaS 육성 비전과 민·관 협력 가교 역할을 강조하여, 대만 현지 기업들의 신뢰를 확보하고 공급망 다변화를 위한 민·관 협력 채널 구축을 제안
- (Coasia) 대만 반도체 생태계 내 DSP 입지를 활용해 현지 유력 AI 인프라(서버네트워크) 기업들을 사전에 접촉섭외하고, 본 회의 테이블로 유도하여 글로벌 밸류체인 연계 방안을 논의

■ 대만 현지 미팅을 위한 주요 안건 및 진행 전략 논의

- (정부 주도 GPU 인프라 협력) 코아시아가 사전 섭외한 대만 인프라 기업들과 한국 GPUaaS 사업 기조를 연계하여, 장기적 장비 공급 및 안정적 글로벌 공급망 파트너십 구축을 제안
- (AI 반도체 해외실증 수요처 발굴) 사전 타깃팅된 대만계 화이트박스 서버 제조사를 대상으로 국산 NPU 스펙을 피칭하고, 글로벌 풀스택 AI 실증을 위한 해외 수요처 참여를 설득
- (NVIDIA '팀 타이완' 전략 제휴) 엔비디아 핵심 공급망을 쥐고 있는 대만 인프라 생태계와 사전 교감하여, AI 칩 수급부터 초고속 네트워크까지 아우르는 'AI 풀스택' 공동 참여 모델을 구상
- (국내 인프라 효율화 및 기술 협업) 국내 GPUaaS의 병목현상을 해결하기 위해, 사전에 기술적 접점을 확인한 대만 네트워크·서버 기업과 국내 서버 인프라간의 실무 협력(PoC)을 타진



코아시아-대만한인회-NIPA 미팅

□ Accton & Edge-core

- (일시) 2026. 6. 3.(수) 11:00~14:00
- (장소) Nankang Software Park Post Office 13층 회의실
- (참석자) NIPA 정도균 수석, 한상범 책임, 안연수 선임, 코아시아 신동수 CEO, 이덕형 전무, 이재승 매니저, Rick Wu 과장, Accton Paul Kim CIO, Edge-core 김민철 한국지사장, Lin Yi Neng 박사 등 10명
- (주요내용) 기업 및 제품소개, 글로벌 기업 협력 방향 및 애로사항 등 논의

< 회의 주요내용 >

■ 기관별 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (NIPA) 국내 AI 생태계 조성 및 GPUaaS 인프라 확산을 위한 정부 지원 정책·비전 제시
- (Accton / Edgecore) 100G~800G급 대용량 AI 스위치, 차세대 광학 인프라, 고밀도 액체 냉각 기반 서버 패브릭 통합 역량 제시
- (Coasia) AI 반도체 디자인하우스(DSP) 역량을 바탕으로, 대만 제조 생태계와의 칩 설계·양산 협력 및 아시아 AI 하드웨어 밸류체인 연계 지원

■ 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (정부 주도 GPU 인프라 협력) 한국 정부의 대규모 GPU 인프라 및 GPUaaS 사업 육성 의지를 피력하고, 안정적인 글로벌 공급망 다변화 논의
- (AI반도체 해외실증 수요처 발굴) 국산 양산급 반도체 해외 실증을 위한 해외 서버사 수요처 발굴 및 고성능 NPU 소개로 대규모 해외 풀스택AI 실증 논의
- (NVIDIA '팀 타이완' 전략 제휴) 엔비디아 핵심 밸류체인과 협력해 AI 칩 수급, 서버 보드 설계, 초고속 네트워크를 아우르는 'AI 풀스택 인프라 체계' 모색
- (인프라 효율화 및 기술 협업) 국내 GPUaaS 구축 시 병목현상을 해결하기 위해 Accton의 오픈 네트워킹 기술과 국내 서버 인프라 간 실무 협력 타진



엑톤-엣지코어-코아시아-NIPA 미팅

□ Inventec & 한중경제협회

- (일시) 2026. 6. 4.(목) 10:00~12:00
- (장소) Nankang Software Park Post Office 13층 회의실
- (참석자) NIPA 정도균 수석, 박예찬 책임, 안연수 선임, 코아시아 신동수 CEO, 이덕형 전무, 이재승 매니저, 한중경제협회 서정원 부회장, Inventec Justen Chen Director, Roger Cheng Director, Sunday Liu Manager, Henry Tsai Manager, Wenchen Chen Manager 등 12명
- (주요내용) 기업 및 제품소개, 글로벌 기업 협력 방향 및 애로사항 등 논의

< 회의 주요내용 >

■ 기관별 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (NIPA) 국내 AI 컴퓨팅 경쟁력 강화를 위한 정부 주도 GPU 인프라 확충 계획 및 국산 AI 반도체 해외 실증 및 도입 확대 방안 공유
- (Inventec) 엔비디아 AI 서버(Blackwell 등) 전문 ODM 제조 역량 및 고효율 수랭식 데이터센터 냉각 솔루션 기술력 제시
- (한중경제협회) 아시아 핵심 정보통신(ICT) 제조 공급망 내 한국-대만 기업 간 민간 경제 협력 및 글로벌 비즈니스 네트워크 매칭 지원
- (Coasia) 글로벌 AI 서버 제조사인 인벤텍과의 협력을 위해 최적화된 custom AI 칩(ASIC) 디자인 솔루션을 제시하고, 대만 제조 밸류체인과의 가교 역할 지원

■ 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (글로벌 AI 서버 공급망 다변화) 인벤텍의 고성능 AI 서버 제조 밸류체인을 활용하여 국내 GPU 인프라 구축에 필요한 핵심 하드웨어의 안정적 수급 구조 다변화 논의
- (AI 서버 공동 개발 및 반도체 실증) 국내업체의 아키텍처와 인벤텍의 생산 노하우를 결합한 글로벌 표준 AI 서버 개발 및 국산 AI 반도체 탑재·실증 협력 가능성 모색
- (민간 비즈니스 교류 활성화) 한중경제협회와 NIPA의 네트워크를 활용하여 인벤텍과 국내 AI 기업 간 지속적인 파트너십 구축 및 상호 비즈니스 기회 발굴 지원



인벤텍-코아시아-한중경제협회-NIPA 미팅

□ Pegatron & 한중경제협회

- (일시) 2026. 6. 4.(목) 14:00~18:00
- (장소) TaiNEX 1, 쉐라톤 타이베이 호텔
- (참석자) NIPA 정도균 수석, 박예찬 책임, 안연수 선임, 코아시아 신동수 CEO, 이덕형 전무, 이재승 매니저, 한중경제협회 서정원 부회장, PEGATRON Kevin Chien Director 등 8명
- (주요내용) 기업 및 제품소개, 글로벌 기업 협력 방향 및 애로사항 등 논의

< 회의 주요내용 >

■ 기관별 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (NIPA) 국산 AI 반도체(NPU 등)의 시장 진입을 위한 실증 지원 사업 및 국내 고성능 엣지·서버 인프라 구축 비전 공유
- (Pegatron) 엔비디아 블랙웰(GB200 등) 지원 차세대 AI 서버 제조 역량 및 대규모 AI 데이터센터 인프라 솔루션 기술력 제시
- (한중경제협회) 한국-대만 간 민간 경제 협력 채널을 기반으로, 글로벌 제조 밸류체인 연계 및 교류 활성화를 위한 네트워크 지원
- (Coasia) 엔비디아 블랙웰 등 페가트론의 차세대 서버 인프라에 대응하는 맞춤형 가속기 (ASIC) 디자인 솔루션을 제시하고, 하드웨어 연계를 위한 실무 기술 협력 지원

■ 주요 역할 및 협력 가능 영역 논의

- (AI 데이터센터 인프라 협력) 페가트론의 차세대 AI 서버(엔비디아 블랙웰 기반 등) 제조 역량과 연계하여 국내 대규모 AI 인프라 구축을 위한 하드웨어 공급 및 기술 협력 논의
- (국산 AI 반도체 탑재 및 공정 실증) 페가트론의 글로벌 하드웨어 플랫폼 및 AI 기반 스마트 제조 공정에 국산 AI 반도체를 적용·실증하는 상용화 협력 가능성 타진
- (민관 협력 네트워크 구축) 한중경제협회와 NIPA의 지원을 기반으로, 페가트론과 국내 AI 기업 간 지속적인 기술 교류 및 비즈니스 파트너십 기회 모색



페가트론-코아시아-한중경제협회-NIPA 부스 투어 및 미팅

□ 딥엑스(DEEPX)

- (일시) 2026. 6. 2.(화) 16:00~18:00
- (장소) TWTC (Taipei World Trade Center Hall 1)
- (참석자) NIPA 정은주 수석, 손예지 책임, 딥엑스 김녹원 대표이사, 박영섭 이사 등 4명
- (주요내용) 기업 소개, 해외진출 현황 공유 및 애로사항 등 논의

< 회의 주요내용 >

■ 중동 시장 진출 애로사항

- (시장 불확실성 및 세일즈 파이프라인 부재) 한국·미국·중국과 달리 UAE 등 중동은 현지 네트워킹(라포 형성)에 최소 1년 이상 소요되며 기술적 이해도가 낮아 현지 솔루션 논의 대상 및 시장 분석이 모호한 경향 있음
- (리스크 회피 성향) 중동은 막대한 자본을 바탕으로 확실한 결과물을 원하며, 검증되지 않은 초기 기술의 테스트베드가 되는 것을 기피하고 타국 성공 레퍼런스를 선호함

■ 중동 등 해외진출 관련 정부 지원 요청사항

- (철저한 현지 수요 기반 진출) 정부가 타깃 분야를 선정하고 UAE 등 중동 현지 핵심 B2B 기업과의 온라인 미팅 등 파트너십 매칭(수요 파악)을 주도해 줄 것을 요청
- (국가별 맞춤형 턴키(Turn-key) 컨소시엄 구성) 정부·비정부 니즈별로 진출 분야를 세분화하고, AI 풀스택 버티컬 컨소시엄을 구성해 수요국에 제안하는 전략 필요 (딥엑스는 중립적 칩 벤더로서 컨소시엄 참여 의향 적극 피력)
- (G2G/B2B 협력 확대) 해외 투자청(UAE 투자청, Mubadala) 등 정부 기관을 비롯하여 실제 기술을 구매할 현지 대형 B2B 기업들의 초청/연계가 강화되어야 함
- (글로벌 RFI 플랫폼 구축) 향후 우리 기업들이 해외 국가 사업 입찰 정보(RFI/RFP)를 조기에 확보하고 지원할 수 있도록 정부가 채널 역할을 해줄 것을 제안



딥엑스 부스



딥엑스 미팅

□ 래블업(Lablup)

- (일시) 2026. 6. 4.(목) 11:00~13:00
- (장소) TWTC (Taipei World Trade Center Hall 1)
- (참석자) NIPA 정은주 수석, 손예지 책임, 래블업 심민석 Sales Associate, 박주희 Sales Account, 황지원 CFO 등 5명
- (주요내용) 기업 소개, 해외진출 현황 공유 및 애로사항 등 논의

< 회의 주요내용 >

■ 중동 시장 인식 및 진출 전략

- (타깃 집중형 밀도 있는 진출 필요) 스타트업 특성상 리소스가 부족하고 중동 AI 시장 자체가 타 권역 대비 아직 크지 않으므로, 불특정 다수 공략보다 확실한 수요처를 타깃으로 한 밀도 있는 접근이 유효함
- (B2B 기회 발굴 최우선) 당장의 투자 유치보다는 실질적인 비즈니스 기회 및 레퍼런스를 생성할 수 있는 작은 기회라도 발굴하는 것이 시급
- (국가별 전략 차별화) UAE는 당사 투자 유치에 관심 표명, 당사는 싱가포르 및 아태(APAC) 지역은 지사 인프라 활용, 대만은 현지 하드웨어 파트너 발굴 중

■ 협력 모델 제안

- (HW-SW 동반 진출 필요성) 래블업은 AI 소프트웨어(플랫폼) 기업이므로, 하드웨어(서버·칩 등) 인프라 기업과 패키지 형태로 연계하여 동반 진출하는 모델이 필수적



엔비디아 파트너 스타트업 부스



래블업 미팅

참고1

COMPUTEX 2026 개요

COMPUTEX 2026

□ 행사명 : COMPUTEX TAIPEI 2026

* 1981년 창설, 올해로 46회째를 맞는 아시아 최대·세계 3대 ICT 박람회

□ 기 간 : 2026년 6월 2일 - 5일 (4일간)

□ 장 소 : 대만 타이베이 내 4개 권역(TaiNEX (1, 2), TWTC, TICC)

□ 주 최 : 중화민국대외무역발전협회(TAITRA), 타이페이컴퓨터협회(TCA) 공동주최

□ 면 적 : 11만m²

□ 주 제 : AI Together

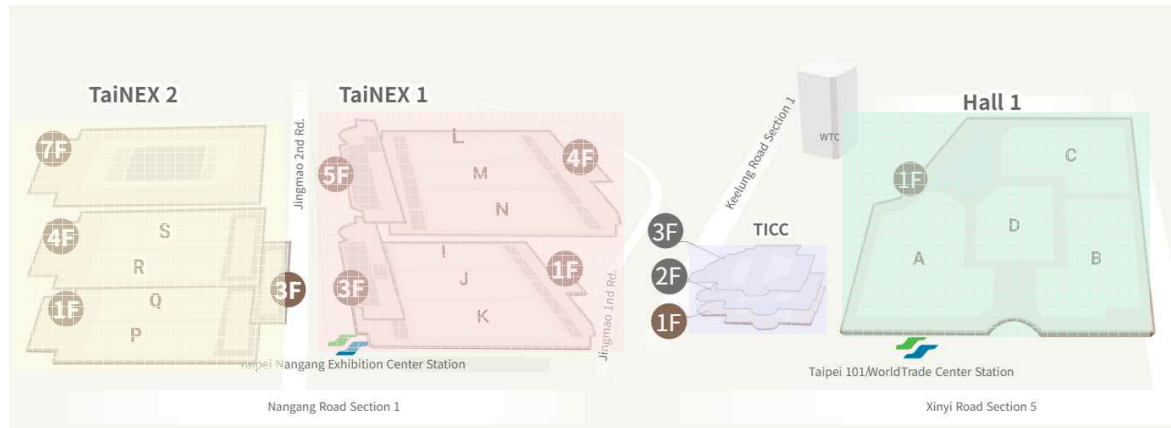
□ 규 모 : 세계 33개국 1,500여개사('26년 기준)

□ 내 용 : AI & 컴퓨팅, 로봇틱스 & 모빌리티, Next-Gen Tech

< COMPUTEX 2026 주제 >

주제	주요 내용
AI & Computing	AI Factory, Agentic AI, Inference 등
Robotics & Mobility	AI 로봇머신비전임베디드, Smart Mobility & Drone Tech 등
Next-Gen Tech	TechXperience Zone, ePaper Pavilion, Gaming, Advanced Power Tech 등
COMPUTEX Forum	AI 컴퓨팅 아키텍처, 클라우드-엣지, 엔터프라이즈 도입, AI 거버넌스 등
스타트업·부대행사	InnoVEX(스타트업·VC·국가관), Procurement Meetings (바이어 매칭), ESG GO Initiative, Guided Tour 등

< COMPUTEX 2026 전시장 구성 >



TaiNex 1 (AI인프라 및 HW)	기가바이트, 에이서, ASUS 등 글로벌 빅테크 기업의 초대형 메인 부스가 위치하고 있으며, 차세대 AI 가속 서버(블랙웰 랙 등), 반도체 칩셋, 엔터프라이즈 스토리지와 인프라의 발열을 잡는 수랭 및 액침냉각 솔루션 기술이 다수 공개됨
TaiNex 2 (InnoVEX)	글로벌 혁신 스타트업 공동관인 이노벡스(InnoVEX)와 스마트홈, 차세대 통신 분야 부스가 위치하고 있으며, AI 데이터센터용 고속 네트워크 (Wi-Fi 7, 5G/6G), 친환경 전력 공급 장치(UPS), 지능형 스마트 가전 및 클라우드 관리 플랫폼 관련 기업의 혁신 기술이 다수 공개됨
TWTC (피지컬 AI 및 모빌리티)	산업 현장 및 일상에 적용되는 피지컬 AI(Physical AI) 중심의 특별 전시관이 위치하고 있으며, 제조·물류 자동화 로봇 솔루션, 자율주행 차량용(Automotive) 하드웨어, 스마트 헬스케어 단말 및 친환경 저 전력 전자종이(E-Paper) 가전 기술이 다수 공개됨
TICC (NVIDIA GTC Taipei)	엔비디아 중심으로 테크 리더들의 미래 비전 공유와 비즈니스 네트워킹을 위한 전문 컨퍼런스 홀이 위치하고 있으며, 엔비디아를 비롯한 글로벌 빅테크 기업 CEO들의 메인 기조연설(Keynote)이 진행되며, 글로벌 미디어 소통, 공급망 파트너십 구축을 위한 전문가들의 모임과 행사가 다수 진행됨

참고3

COMPUTEX 2026 참가업체

구분	분야	기업명 (영문)	주요 전시 내용
1	AI Computing & Tech	NVIDIA	차세대 Blackwell/Rubin 아키텍처 GPU, AI 공장(AI Factory) 및 자율 이동 로봇(Physical AI) 솔루션
2		AMD	Ryzen AI Max 프로세서(에이전트 컴퓨팅), Instinct MI430X 가속기 및 ROCm 오픈 소프트웨어 생태계
3		Intel	차세대 Lunar Lake/Panther Lake AI PC 플랫폼, Gaudi AI 가속기 및 시스템 파운드리 비전
4		MediaTek	Dimensity 시리즈 기반 하이브리드 AI, 모바일-차량-클라우드 연결 통합 AI 가속 기술
5		Realtek	AI 기반 지능형 네트워크 컨트롤러, 고해상도 오디오/비디오 AI 처리 전용 칩셋
6		LENOVO	온디바이스 AI 에이전트가 탑재된 AI PC 라인업, 엔터프라이즈용 하이브리드 클라우드 서버
7		ASUS	Copilot+ PC(Zenbook/Vivobook), MuseTree 등 창작용 AI 툴 및 의료/산업용 엣지 AI 시스템
8		MSI	AI 연산 최적화 워크스테이션, 차세대 게이밍 NPU 탑재 노트북 및 지능형 쿨링 솔루션
9		GIGABYTE	AI 데이터센터용 GigaStar 서버 시리즈, 고성능 수랭식 AI 랙 솔루션 및 마더보드
10		ACER	친환경 소재와 AI 기술을 결합한 스위프트(Swift) 시리즈, AI 에듀테크용 디바이스
11		Supermicro	NVIDIA 밀착 협력 기반의 액체 냉각 AI 서버 랙, 하이퍼스케일 데이터센터 아키텍처
12		Foxconn	엔비디아 GB200 서버 대량 생산 공정, 스마트 제조 및 전기차 전용 AI 플랫폼
13		Quanta	글로벌 빅테크 전용 맞춤형 AI 서버 인프라, 고집적 데이터 저장 및 처리 시스템
14		Wiwynn	오픈 컴퓨팅(OCP) 기반 차세대 데이터센터 솔루션, AI 연산을 위한 고효율 전력 관리
15		Inventec	서버 및 노트북 위탁 설계 제조, AI 기반 스마트 팩토리 솔루션 및 엣지 컴퓨팅 하드웨어
16		Kingston	AI 연산 부하를 견디는 고클럭 DDR5 메모리, 서버용 고용량 엔터프라이즈 SSD
17		ADATA	AI 학습/추론 데이터를 위한 고속 PCIe Gen5 SSD 및 산업용 냉각 메모리 모듈
18		Essencore	고성능 게이밍 및 AI 워크스테이션용 KLEVV 브랜드 메모리/SSD 최신 라인업
19		Advantech	산업 현장 최적화 엣지 AI 컴퓨팅 박스, 로봇틱스 및 스마트 시티 통합 제어 시스템
20		Pegatron	AI 서버 시스템 통합(SI) 및 통신 장비 제조, 프라이빗 5G와 AI 결합 솔루션

21	AI Computing & System Integration	ASRock Rack	AI 학습용 고밀도 GPU 서버 설계 및 액체 냉각(Liquid Cooling) 시스템 통합 솔루션
22		ASRock Industrial	제조 공정 자동화를 위한 엣지 AI 컴퓨팅 박스 및 지능형 공장 제어 시스템
23		MiTAC Computing	하이퍼스케일 데이터센터 아키텍처 및 클라우드-투-엣지(Cloud-to-Edge) 통합 서버 플랫폼
24		Inspur (Inspur Systems)	오픈 컴퓨팅 서버 솔루션 및 거대언어모델(LLM) 최적화 인프라 구축 서비스
25		Clientron	스마트 리테일(무인 점포), AI 키오스크 및 지능형 POS 시스템 솔루션
26		7StarLake	국방 및 자율주행용 고성능 러기드(Rugged) 컴퓨터 및 임베디드 AI 제어 솔루션
27		Lanner Electronics	AI 기반 네트워크 보안 가전 및 엣지 AI 기반 지능형 영상 분석(VMS) 플랫폼
28		Aetina	NVIDIA Jetson 파트너로서 산업용 엣지 AI 모듈 및 컴퓨터 비전 가속 솔루션
29		Leadtek	NVIDIA Omniverse 기반의 디지털 트윈 솔루션 및 AI 시각화 워크스테이션
30		ELAN Microelectronics	노트북용 AI 터치패드, 생체 인식 센서 및 휴먼-머신 인터페이스(HMI) 솔루션
31		PROMISE Technology	고성능 비디오 스토리지 솔루션 및 AI 기반 지능형 도시 감시 시스템
32		AIC Inc.	기업 맞춤형 고성능 스토리지 서버 및 AI 연산용 랙마운트 새시 솔루션
33		PNY Technologies	엔비디아 RTX 및 데이터센터 GPU 공급, AI 연구용 전문 렌더링 및 연산 인프라
34		Chenbro	전 세계 서버 새시 1위 기업으로 AI 서버 전용 고효율 인클로저 및 냉각 구조 전시
35		Innodisk	AI용 산업용 메모리 및 공장 내 물류 로봇(AMR) 제어를 위한 통합 하드웨어 솔루션
36		D-Link	AI 기반 지능형 Wi-Fi 솔루션 및 보안성이 강화된 클라우드 네트워크 관리 플랫폼
37		QNAP Systems	AI 가속기가 장착된 NAS(네트워크 저장소) 및 로컬 LLM 구동용 스토리지 솔루션
38		Zyxel Networks	중소기업(SMB)을 위한 AI 기반 자동 네트워크 최적화 및 보안 솔루션
39		HANNStar	초저전력 종이 디스플레이 및 AI 센서가 통합된 지능형 대화형 패널
40		Colorful	AI 가속 기능이 강화된 하이엔드 그래픽 카드 및 고성능 AI 노트북 라인업

41	Components & Advanced Power Tech	Delta Electronics	AI 서버용 고효율(98%+) 전원 공급 장치, 데이터센터용 지능형 전력 관리 시스템
42		Lite-On Technology	하이퍼스케일 클라우드용 전력 솔루션 및 AI 워크스테이션용 고출력 PSU
43		FSP Group	차세대 ATX 3.1 규격 파워서플라이, 산업용 엣지 AI 기기 전용 전원 장치
44		Sea Sonic (Seasonic)	하이엔드 게이밍 및 AI 딥러닝 시스템용 프리미엄 고효율 전원 공급 장치
45		Chicony Power	노트북 및 소형 가전용 지능형 전력 변환기 및 차세대 GaN(질화갈륨) 어댑터
46		Cooler Master	AI 서버용 액체 냉각(Liquid Cooling) 솔루션 및 차세대 히트파이프 기술
47		Thermaltake	고성능 AI PC 및 랙 마운트 서버용 커스텀 수랭 솔루션과 지능형 쿨링팬
48		Auras Technology	AI 노트북 및 서버용 초박형 베이퍼 챔버(Vapor Chamber) 솔루션
49		DeepCool	고성능 CPU/GPU 냉각 솔루션 및 효율적인 공기 흐름 설계를 위한 시스템 새시
50		Sunonwealth (Sunon)	AI 데이터센터 및 차량용 고압·고풍량 쿨링팬 및 방열 모듈
51		Chenbro Micom	AI GPU 서버 전용 고밀도 랙마운트 새시 및 유지보수가 쉬운 모듈형 케이스
52		Lian Li	AI 워크스테이션 구축을 위한 고성능 새시 및 케이블 통합 솔루션
53		In Win Development	창의적인 디자인의 PC 케이스 및 서버/임베디드 시스템용 인클로저
54		SilverStone	소형 폼팩터(SFF) AI 기기용 특수 새시 및 고출력 밀도 전원 장치
55		Lotes	AI 가속기 및 CPU 소켓용 정밀 커넥터, 차세대 PCIe 6.0/7.0 지원 슬롯
56		BizLink	AI 데이터센터 내부의 고속 데이터 전송 케이블 및 전력 케이블 어셈블리
57		Shinkoshizai	반도체 제조 및 고밀도 회로 기판용 특수 소재 및 정밀 부품
58		Thinking Electronic	AI 서버 전력망 보호를 위한 과전류/과전압 보호 소자 및 센서
59		Team Group	고성능 AI 연산용 T-FORCE DDR5 메모리 및 수랭식 산업용 SSD
60		Apacer	산업용 AI 시스템을 위한 고내구성 저장 장치 및 데이터 보안 솔루션

61	Storage & Management Solutions	Synology	AI 기반 영상 감시(Surveillance), 데이터 보호 및 하이브리드 클라우드 스토리지 솔루션
62		QNAP Systems	AI 가속기 지원 NAS, 고속 25GbE 네트워크 스위치 및 로컬 AI 모델 구동용 서버
63		Thecus Technology	대규모 데이터 처리를 위한 기업용 랙마운트 스토리지 및 데이터 보안 관리 기술
64		Asustor	크리에이터 및 중소기업에 위한 고속 NVMe 기반 플래시 NAS 라인업
65		Kingston	데이터센터용 엔터프라이즈 SSD(DC 시리즈) 및 고성능 서버용 DDR5 메모리
66		Team Group	AI 학습용 초고속 PCIe Gen5 SSD 및 산업용 특수 방열 스토리지 솔루션
67		Transcend	블랙박스, 산업용 장비 및 임베디드 시스템 전용 고내구성 메모리/SSD
68		Patriot Memory	Viper 시리즈 고성능 SSD 및 AI 워크스테이션용 대용량 메모리 키트
69		Apacer	AIoT 및 엣지 컴퓨팅을 위한 데이터 무결성 보장 산업용 스토리지 기술
70		Silicon Motion	전 세계 SSD 점유율 1위 컨트롤러, 차세대 PCIe 5.0 인터페이스 최적화 칩셋
71		Solidigm	SK하이닉스 계열사로 AI 및 클라우드 데이터센터에 최적화된 초고용량 QLC SSD
72		JMicron	고속 데이터 전송을 위한 USB-to-NVMe 브리지 칩셋 및 외부 저장장치 솔루션
73		Inspur	글로벌 서버 3위 기업으로서의 AI 인프라 관리 소프트웨어 및 풀스택 AI 서버
74		ASPEED	전 세계 서버 관리 칩(BMC) 시장 1위, AI 서버의 안정적인 모니터링 솔루션
75		AIC Inc.	고집적도 JBOD(Just a Bunch of Disks) 스토리지 랙 및 확장형 서버 새시
76		Infortrend	고가용성 공유 스토리지 및 AI 분석을 위한 엔터프라이즈급 SAN/NAS 솔루션
77		Buffalo	비즈니스 연속성을 위한 자동 백업 시스템 및 랜섬웨어 대응 스토리지 솔루션
78		Datalocker	하드웨어 암호화가 적용된 보안 외장 하드 및 중앙 집중식 보안 관리 플랫폼
79		TP-Link	데이터 전송 병목 현상을 해결하는 10G/25G 광 스위치 및 비즈니스 네트워크 관리
80		NETGEAR	스토리지 전용 고성능 AV-over-IP 스위칭 솔루션 및 클라우드 관리 네트워크